

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

江西沃格光电集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐电话会议
活动参与机构名称	国海证券、大成基金、平安基金、国联基金、中信证券、深圳博普科技、全天候基金、雾凇资本、中银资管、中银证券
公司接待人员	董事会秘书龚庆宇
时间	2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 18 日
地点	沃格光电深圳分公司
交流内容及具体问答记录	一、公司业务介绍 江西沃格光电集团股份有限公司是国家高新技术企业，正从传统显示玻璃精加工向“玻璃基+”高端制造全面升级，聚焦显示、通信与半导体三大领域，公司是全球最早实现玻璃电路板（GCP）产业化的企业。 公司主营业务主要包括三大块。第一是沃格光电公司及子公司为经营主体的传统业务，包括显示面板相关玻璃精加工和显示器件产品业务；第二是以江西德虹显示为经营主体的新型显示业务，包括玻璃基 Mini LED 背光新型显示模组、Micro LED 直显玻璃基板两大类。

第三是以湖北通格微为经营主体的玻璃基线路板和玻璃器件产品在泛半导体行业的应用，包括 5G-A\6G、卫星通信玻璃基 RF 射频器件、光通讯领域光模块/CP0、半导体先进封装领域玻璃基 Chiplet 先进封装载板及其封装技术开发和应用。目前，公司主营业务以第一块业务贡献为主，第二块和第三块业务取得较好进展和应用突破。

此外，公司积极参与玻璃基微流控生物芯片的开发，航天卫星太阳翼材料的开发及加工、半导体刻蚀设备和光刻机用玻璃器件及加工工艺开发等领域。

2025 年 1 - 9 月，公司实现营收 19 亿元，同比增长 15.66%；研发费用 1.26 亿元，同比增长 50.90%；公司传统业务业绩保持盈利并稳健增长，由于持续加大在玻璃电路板等新产品新技术的研发投入，以及新产线投产带来折旧等固定成本的上升，导致归母净利润为-6,694 万元，但经营性现金流仍达 1.26 亿元，主业造血能力稳健。公司拥有授权专利超 500 项（其中发明专利 135 项），技术壁垒持续强化。

二、问答环节

1. 公司 8 代 AMOLED 玻璃基精加工产线建设进度？设计产能？在行业内的地位？预计对公司的经营影响？

回复：公司全资子公司成都沃格显示技术有限公司采用独家开发的 ECI 玻璃薄化、丝印、切割一体化技术，为国内首条 8 代 AMOLED 产线提供玻璃基精加工配套服务，该项技术公司协同客户联合开发逾 4 年，是目前国内唯一具备 ECI 技术能力的公司。现在正处于设备搬入阶段，预计 2026 年进入量产，达产年预计实现月产能 2.4 万片，达产后预计能为公司玻璃精加工业务带来收入大幅增长。

成都沃格项目的启动，推动了公司独家自主开发的玻璃基 ECI 技术在中大尺寸 AMOLED 显示屏的首次产业化应用，该技术为公司后续持续深度参与国内外先进面板厂 8 代 AMOLED 相关产品的市场化应用打下坚实基础，进一步夯实公司玻璃精加工技术在业内的领先地位，同时有助于提升公司的长期盈利水平，为公司创造新的利润增长点。

	2. 公司传统业务的经营情况及发展趋势？过去业绩亏损的主要原因？ 回复：公司传统业务主要包括显示面板相关玻璃精加工和显示器件产品业务，公司目前收入和利润贡献主要都来自于传统业务，公司自 2018 年上市以来，传统业务保持稳健增长，2019 年至 2024 年营收年复合增速超过 30%，传统业务利润保持盈利稳健。2025 年受益于国内 8 代 IT 产线产能释放对于玻璃精加工业务的需求，公司玻璃精加工业务产能满产，并通过产品结构的改善实现盈利能力的提升。 公司业绩亏损的主要原因是持续对玻璃电路板（GCP）新产品、新技术的投入，包括引进核心技术人员费用增加和新产品研发投入持续增长，以及建设了江西德虹玻璃基 MiniLED/MicroLED、湖北通格微 TGV 先进封装这两条玻璃基产线，新产线折旧成本增加，公司在今年陆续实现产品技术突破以及客户导入，随着新客户拓展和订单陆续落地，预计明年开始经营业绩将逐步改善。 3. 江西德虹主要是做玻璃基 MiniLED 背光产品，行业趋势如何？产能和客户拓展情况？ 回复：MiniLED 背光显示行业在过去几年快速发展，根据 Omdia 数据显示，2025 年 MiniLED 电视销量预计突破 1300 万台，同比翻倍以上增长。MiniLED 背光成为各大电视品牌客户中高端机型的主要配置，并呈现 MiniLED 分区数量提高、显示性能要求提升的趋势。随着 MiniLED 背光分区数量的提升，玻璃平整度高、热膨胀系数低，在高密度 LED 芯片发热情况下不易翘曲，同时满足高密度线路下兼具成本优势，玻璃基 MiniLED 的性能和成本竞争优势逐步开始体现。 江西德虹显示已具备一期年产 100 万平米玻璃基 Mini LED 基板产能，经历过去两年投入和工艺改善，公司生产的玻璃基 MiniLED 背光产品已满足量产工艺需求，并达到较高的良率水平。今年开始在海信发布的大圣 G9 电竞显示器应用，并已进入正式批量量产阶段，同时，公司正在和十余家国内外知名品牌客户合作开发玻璃基
--	---

	Mini LED 新产品，包括在 TV、显示器、娱乐机、车载等产品。预计明年订单陆续落地将带动江西德虹经营改善。 4. 请问公司在玻璃基封装领域进展如何，公司在行业内的市场地位和竞争优势？ 回复：公司在玻璃基封装领域具备显著的先发优势和技术壁垒，是全球少数掌握“薄化、镀膜、黄光、TGV、精密镀铜、多层线路制作”等全制程核心工艺并实现产业化的企业之一。核心技术指标方面，公司 TGV 工艺可实现最大深宽比 100:1、最小孔径 5 μm、加工厚度 0.05-1.1mm，达到行业领先水平。公司已建成首条年产 10 万平米 TVG 产线，产品在 Micro LED、5G-A/6G 射频、光模块/CP0、大算力芯片先进封装、微流控生物芯片等多领域同步推进，与国内外多家头部企业开展合作，公司在技术完整性、产业化经验及客户协同方面具备全球竞争力。 公司近期牵头发起中国玻璃线路板产业联盟，旨在推动 GCP 技术的持续创新和产业链协同，实现更高性能、更低成本、更优良率的规模化应用。在 MicroLED 领域，公司联合多家海外和国内客户开展产品研发，光模块 CP0 玻璃基产品在今年下半年完成批量送样，算力芯片先进封装领域和客户开展战略合作，持续推进玻璃叠构技术迭代升级，微流控生物芯片产品即将进入量产出货阶段。 5. 在显示、通信、半导体等多个领域均出现了玻璃基的应用趋势，包括海外的芯片巨头也都在投入玻璃基先进封装，玻璃基有什么优势？ 回复：玻璃基板之所以成为显示、通信、半导体等多个领域的技术热点，是因为其相比传统有机基板和硅基板，在以下方面具备显著优势，能够很好地满足未来科技产业对高性能、高可靠性及成本效益的综合需求： ① 热稳定性高：玻璃基板的热膨胀系数与硅芯片更为接近，能有效减少高温环境下的翘曲风险，大幅提升封装可靠性。 ② 低介电损耗：玻璃材料本身是良好的绝缘体，其介电常数和损
--	---

	耗因子远低于硅材料。在高频高速应用场景下（如 5G、AI 芯片），玻璃基板能有效降低信号传输的功率损耗和延迟，确保信号完整性，提升能效比。 ③ 表面平整度：玻璃基板表面极为平整，这为高精度光刻和超高密度布线提供了理想基础。 ④ 高互联密度：玻璃基板可实现高密度通孔互连（通过 TGV 技术），可容纳的功率和数据连接数量远超传统基板，是延续摩尔定律的有效路径之一。 ⑤ 成本优势：得益于大尺寸超薄面板玻璃的易获取性，以及部分工艺流程的简化（例如不需要沉积绝缘层），玻璃基板在大规模生产时具备可观的成本降低潜力。 综上，玻璃基板凭借其综合性能优势，正成为推动先进封装和下一代通信、显示技术发展的关键材料之一，为未来科技产业的发展提供了坚实的基础。 6. 公司在卫星太阳翼领域的产品主要是什么，与公司原有业务有什么关联？目前产品应用和客户拓展情况？ 回复：公司成立之初主要围绕面板加工相关业务，在上市后进行产品化转型，开展了多项新产品、新技术的开发，坚定了在玻璃基线路板的产业化方向。在转型过程中，公司自主研发了多项新技术，包括在 CPI 领域专门成立了研发团队，已经开展了多年的技术研发和储备，今年在卫星柔性太阳翼基材领域实现产品应用，配合头部商业航天客户提供 CPI 膜材及防护镀膜产品，并已实现在轨应用。同时公司积极对接其他客户需求，配合产品送样验证。 公司在 CPI 膜材领域拥有深厚的技术储备，相关技术为自主研发，具备自主知识产权，同时，镀膜技术一直为公司的核心优势，公司已形成 CPI 浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力，技术水平处于行业领先地位。公司看好商业航天柔性太阳翼发展趋势以及太空算力建设对于太阳翼能源供应的需求，随着卫星发射数量的提升以及单颗卫星太阳翼面积的增长，对于太阳翼柔性基材及防护镀膜的需求
--	--

	将高速增长，公司将继续加大柔性太阳翼产品的业务拓展。 7. 公司的产业布局比较广，涉及多个行业，是基于什么考虑？ 回复：沃格光电以传统显示领域玻璃精加工业务起家，目前市占率行业第一，多年的工艺开发技术积累主要沉淀了两方面的核心能力，一是玻璃精加工，二是镀膜/镀铜。目前公司业务布局也主要基于这两方面的能力，重点发展玻璃线路板（GCP）业务，柔性太阳翼基材及防护镀膜等。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、文档等附件（如有）	无